Advanced VAcuum & Clean equipment Optimizer

Investor Relations 2026

첨단 산업에 필요한 핵심 장비를 공급하는
기술 혁신 기업, AVACO

주식회사 아바코



IMPORTANT NOTICE

Disclaimer

본 자료는 투자자들을 대상으로 실시되는 Presentation에서의 정보 제공을 목적으로 **주식회사 아바코**(이하 "회사")에 의해 작성되었으며, 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려 드리는 바입니다. 본 Presentation에의 참석은 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며, 제한 사항에 대한 위반은 관련 증권거래법률에 대한 위반에 해당될 수 있음을 유념해 주시기 바랍니다.

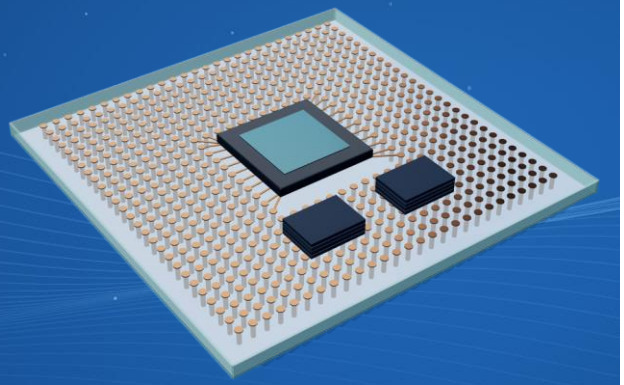
본 자료에 포함된 회사의 경영실적 및 재무성과와 관련된 모든 정보는 기업회계기준에 따라 작성되었습니다. 본 자료에 포함된 "예측정보"는 별도 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대(E)' 등과 같은 단어를 포함합니다.

위 "예측정보"는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래실적은 "예측정보"에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다. 또한, 향후 전망은 Presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로, 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임직원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다(과실 및 기타의 경우 포함). 본 문서는 주식의 모집 또는 매매를 위한 권유를 구성하지 아니하며, 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다.

Contents

Investor Relations



01 Investment Highlights

02 Key Competency

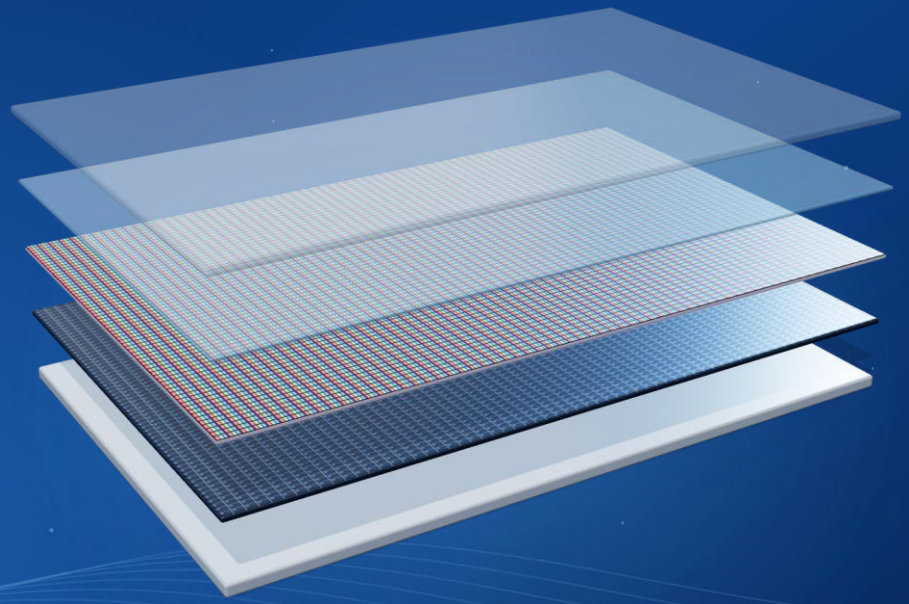
03 Financial Highlights

04 Company Overview

01

Chapter 01

Investment Highlights



산업 이슈 및 대응 전략

핵심 성장 축

핵심 기술 기반의 사업 다각화

경영성과 Review

글로벌 고객사 및 네트워크

01 산업 이슈 및 대응 전략

첨단 산업 전반의 투자 확대가 아바코의 장비 공급 기회로 이어지고 있습니다

디스플레이
Display

글로벌 패널사 투자 계획[1)]

BOE
8.6세대 OLED **11조원** 투자(~27년)

TCL
8.6세대 OLED **6조원** 투자(~28년)

LG Display
8.6세대 OLED **1.1조원** 투자(~28년)

HKC TRULY TIANMA
OLED 투자 기대

대규모 OLED 투자 재개로
진공 이송·박막 증착 장비 수요 확대

글로벌 패널 고객사 레퍼런스를
기반으로 **후속 투자 사이클 대응**

이차전지
Secondary Battery

북미 지역 배터리 예상 생산규모[2)]

700 GWh
2028(E) ~ 2030(E)

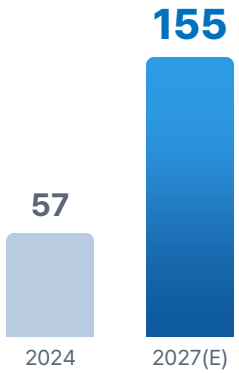
LG Energy Solution
약 **35%** 점유 예상

ESS*·각형 전환과 차세대 배터리 시장
개화로 **공정장비 수요 확대**

전극·자동화 장비 기반에
건식전극·전고체 대응 장비 개발 추진

반도체
Semiconductor & Packaging

세계 AI 반도체 매출 예상 추이[3)]
(단위: 조 원)



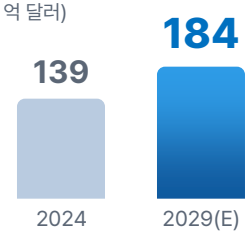
AI·HBM 확산으로
첨단 패키징·유리기판 공정 수요 확대

Metal Sputter·TGV**·PlasmaLine
기반 **고부가 장비 시장 진입** 추진

MLCC
Multi Layer Ceramic Capacitor

온디바이스 AI 시장 개화
전장용 MLCC 연평균 15% 성장 전망[4)]
(2023~2028E)

세계 MLCC 매출 예상 추이[4)]
(단위: 억 달러)



고성능 MLCC 수요 확대로
장비 공급 기회 부각

적층기 등 핵심 공정장비 기반으로
MLCC 사업 확장 추진

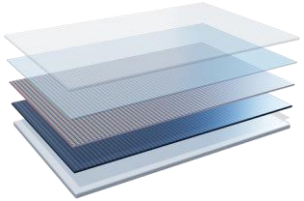
1) UBI Research, OMDIA, 보도내용 참고 2) Marklines, SNE Research, 보도내용 참고 3) 한국반도체산업협회, 보도내용 참고 4) Global Information, 보도내용 참고
*ESS: 에너지 저장 시스템 (Energy Storage System) **TGV: 유리 관통 전극 (Through Glass Via)

02 핵심 성장 축

디스플레이·이차전지·반도체·MLCC, 첨단 산업을 아우르는 성장 포트폴리오를 구축했습니다

Display

OLED 중심
글로벌 장비 공급 확대



Market	OLED 투자 재개 · 글로벌 패널 고객사 증설
Key Equipment	OLED In-line Vacuum · Sputtering · 진공 증착 물류
Growth Focus	**주요 고객사 공급 확대 · 글로벌 고객 기반 강화**

Battery

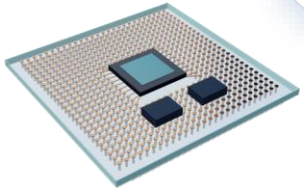
공정 전환·차세대 전극으로
신규 장비 시장 선점



Market	ESS 투자 · 각형 배터리 채택 확대 차세대 전극 상용화
Key Equipment	Roll Press · Slitter · 자동화 · 건식전극 · 리튬메탈
Growth Focus	**차세대 전극 장비 사업화** **AI 적용 자동화 장비 공급 확대**

Semiconductor

첨단 패키징 중심
고부가 신시장 진입



Market	AI · HBM 투자 확대 · 유리기판 상용화 · 첨단 패키징
Key Equipment	Metal Sputter · TGV Laser · PlasmaLine
Growth Focus	**유리기판 · 패키징 장비 사업화 · 고부가 시장 진입**

MLCC

고사양 제품 대응
핵심 공정 장비 확대



Market	전장 · AI 서버 수요 확대 · 고사양 MLCC 수요 증가
Key Equipment	Stacking · Coating · Printing · Dipping
Growth Focus	**핵심 공정 장비 공급 확대 · 해외 고객 기반 다변화**

03 핵심 기술 기반의 사업 다각화

아바코는 첨단 산업에 필요한 핵심 장비를 공급하는 '기술 혁신 기업'입니다

KEY COMPETENCY

핵심 기술



진공박막 증착기술

특허 등록

스퍼터

국내 14건 · 국외 15건

OLED 진공물류

국내 3건 · 국외 3건



고밀도 압연 기술

특허 출원

롤프레스 **국내 1건**

슬리터 **국내 6건**

FPD(Flat Panel Display)
진공·전용·자동화장비 기반 기술 확보

OLED·이차전지·반도체 등 첨단산업 중심으로 확장

디스플레이
LCD + OLED

LCD Sputter
국내 최초
LCD TFT
Sputter(G7)
2006

Low Damage Sputter
차세대 전극용
저손상 증착 기술
2017

OLED
10.5세대 OLED
진공 증착 및
물류 시스템
2018

이차전지

자동화장비
이차전지
자동화 시스템
2020

Roll to Roll
롤프레스·테이핑기·
슬리터·코터 등
공정장비
2023

첨단산업

MLCC
MLCC
생산 장비
2018

PlasmaLine
PCB 건식공정
장비
2020

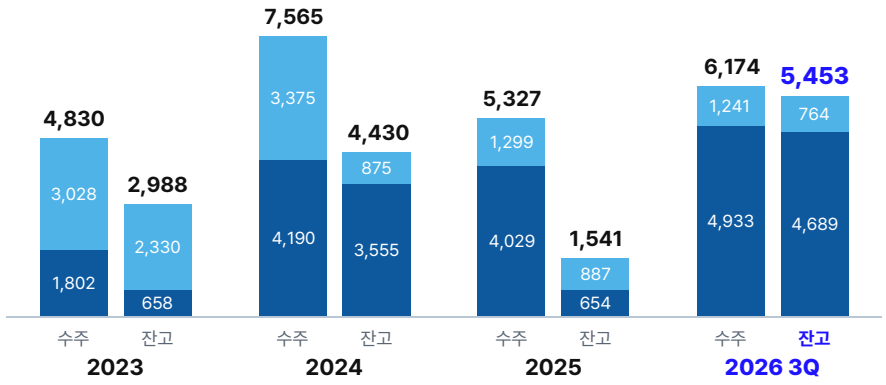
반도체 Metal Sputter
반도체용
증착 장비
2023

TGV Solution
TGV
레이저 가공장비
고도화
2026

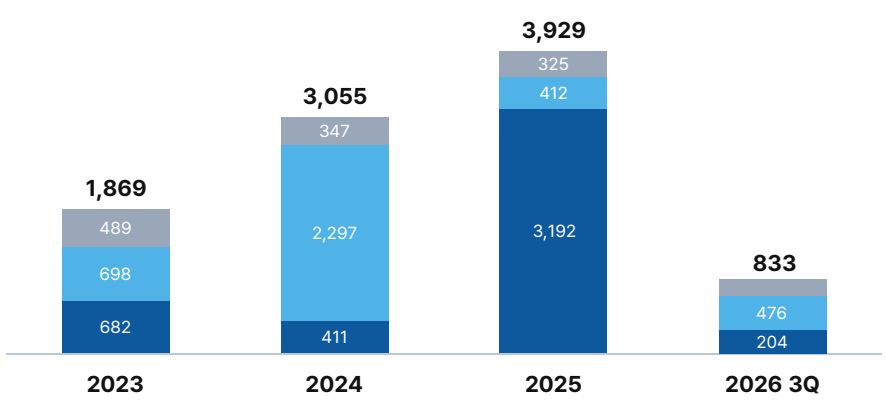
04 경영성과 Review

2026년 3분기 수주잔고 5,453억원 확보, 매출 인식 본격화 기반을 마련했습니다

연 수주총액 및 수주잔고



매출액 추이



출처: 사업보고서

ORDERS & BACKLOG

디스플레이

- 국내외 고객사 증설 투자에 따른 증착·모듈·물류 장비 신규 수주 기대감 지속
- **B사 Phase 2 수주** 반영으로 수주잔고 확대
- 중국 C사 수주 및 주요 고객사 후속 투자 대응

이차전지

- ESS · LFP* 중심 투자 수요 확대 전망
- ESS · 각형 LFP 등 고객사 라인 전환에 따른 **신규 장비 수요에 적극 대응**

*LFP: 리튬인산철 배터리 (Lithium Ferrophosphate)

REVENUE

디스플레이

- 주요 프로젝트 납기에 따라 **매출 인식 반영 예정**
- 추가 수주를 위한 주요 고객사 영업 활동 지속

이차전지

- 기존 납품 경험과 라인 대응 역량을 기반으로 **후속 수주 기회 확보** 추진

기타 장비

- Metal Sputter 국내 OSAT** 업체 양산 평가 진행
- 유리기판 관련 장비 개발 완료 및 샘플 테스트 등 활발한 영업 활동 → **매출 다각화** 추진

**OSAT: 후공정 외주 기업 (Outsourced Semiconductor Assembly and Test)

05 글로벌 고객사 및 네트워크 확보

26년간 쌓아온 글로벌 Top-tier 고객사 레퍼런스와 전문가 네트워크를 보유하고 있습니다

누적 System 공급 실적 (25년 말 기준)	국내 및 해외 특허 보유	연구개발 실적
1,406 Systems	**250 건 이상**	**44 건**
해외 691 Systems	출원 · 등록 포함	디스플레이 28 · 태양광 9 · 반도체 및 기타 7

주요 고객사 Global Customers

LG Display · LG Chem · LG Energy Solution · LG Electronics · BOE · HKC · TCL CSOT · GVO · TIANMA · Visionox · 코오롱인더스트리 · HYOSUNG CHEMICAL · ultium cells · posco · DOOSAN · AVERY DENNISON · MiaSolé · 한화솔루션 · SERVEONE 서브원 · OS ADVANCED MATERIALS · OVIS · 희성전자 · 롯데에너지머티리얼즈

협력 네트워크 R&D Network

ETRI 한국전자통신연구원 · KFE 한국핵융합에너지연구원 · KIER 한국에너지기술연구원 KOREA INSTITUTE OF ENERGY RESEARCH · KAERI 한국원자력연구원 Korea Atomic Energy Research Institute · KSIA 한국반도체산업협회 · 대구테크노파크 DAEGU TECHNOPARK · 대구테크노파크 나노융합실용화센터 · KDIA · DGIST 대구경북과학기술원 · KOPIA 한국태양광산업협회 · 영남대학교 Yeungnam University · 대구가톨릭대학교 DAEGU CATHOLIC UNIVERSITY · 국립군산대학교 KUNSAN NATIONAL UNIVERSITY · KAIST · 연세대학교 YONSEI UNIVERSITY · KNU 경북대학교

02

Chapter 02

Key Competency

디스플레이

이차전지

신성장동력 - PlasmaLine / TGV Solution

반도체 / MLCC

01 디스플레이 (1) 디스플레이 장비 라인업

26년 업력을 기반으로 OLED 디스플레이 핵심 기술과 장비를 보유하고 있습니다



국내 최초 장비 개발

Sputtering System

디스플레이 기판에 산화물·금속 물질을 증착해 박막을 형성하는 진공 증착 시스템

6세대 · 8세대 · 10.5세대



Vacuum Oven System

OLED 증착 전 TFT* Back Panel을 진공 상태에서 Out-gassing하는 장비

Max 10.5세대

*TFT: 박막 트랜지스터 (Thin Film Transistor)



글로벌 기업 수주 국내 최초 8.6세대 양산

OLED In-line Vacuum System

OLED 증착 공정 중 마스크 및 기판을 진공 상태에서 연속적으로 운송

6세대 · 8.6세대



OLED TFE System

패널 증착 이후 진공 상태에서 OLED 손상 없이 TFE(Thin Film Encapsulation) 공정을 진행하기 위한 챔버 등으로 이루어진 System

글로벌 고객사 레퍼런스 보유	해외 유망 기술 기업과 전략적 제휴	포트폴리오 확장
기술 초격차 기반 시장 지위 선점	경쟁력 제고를 위한 연구개발 및 사업화	차세대 디스플레이 공정 장비로 확장

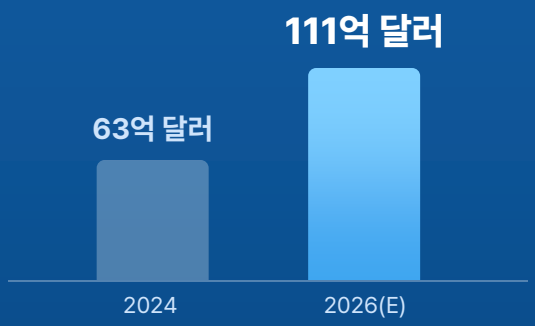
01 디스플레이 (2) 글로벌 OLED 고객사 공급 확대

글로벌 패널사의 OLED 투자 확대 속에서 장비 공급 기회가 커지고 있습니다

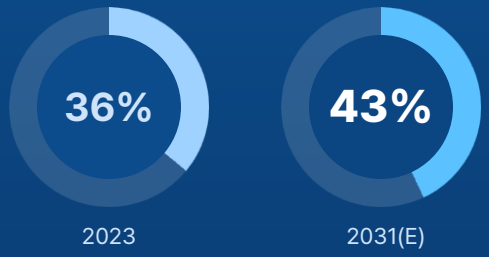
MARKET OUTLOOK

글로벌 OLED 투자 추이

세계 디스플레이 설비투자 예상[1)]



OLED 패널 점유율 전망[2)]



1), 2) 시장분석기관, OMDIA

BOE

8.6세대 IT OLED 분야에 2027년까지 약 11조원 투자

투자 완료 시 **월 3만 2,000장** 생산 가능



OLED In-line Vacuum System 공급 확대

수주 완료	공급 완료
32K 물량 장비	**16K** 물량 장비

2024년	2024년 말 ~ 2025년	2026년
1차 장비 수주 확보	1차 장비 반입	2차 후속 수주 확보

TCL CSOT

OLED 라인 투자 발표

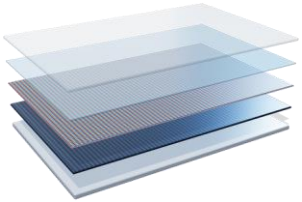
22.5K/월 규모 라인 구축에
약 6조원 투자 발표

OLED 생산라인용 장비 수주 확보
→ 후속 장비 수주 기대

LG디스플레이

OLED 투자 발표

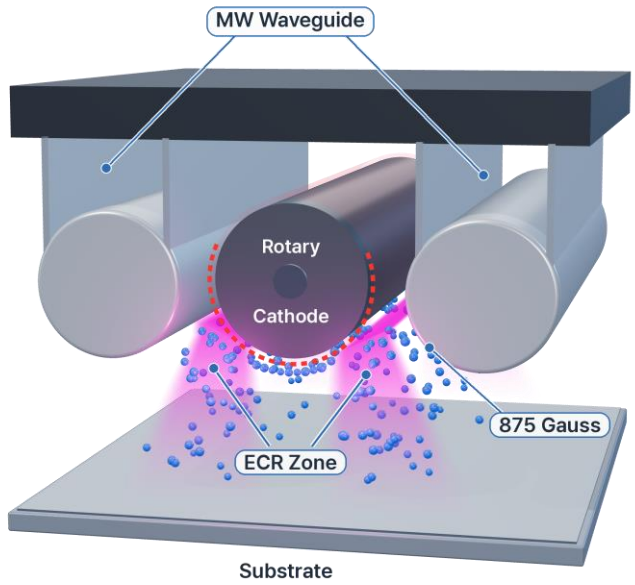
2027년까지 OLED에
1.2조원 투자 발표



01 디스플레이 (3) Low Damage Sputter : 차세대 전극 공정 대응 기술

박막 손상은 줄이고 전극층은 균일하게, 차세대 소자 공정의 핵심 기술입니다

LOW DAMAGE SPUTTERING



CONCEPT
기술 개념

- 민감한 박막의 손상을 줄이는 **저손상 Sputter 증착 기술**
- 투명전극층을 얇고 균일하게 형성

WHY
필요성

- OLED : Top Emission 구현 · 휘도 향상
- 태양전지 : 전기적 · 광학적 특성 유지

→ **손상 최소화 = 성능 · 수율 확보**

AVACO
대응 기술

- 낮은 Voltage 균일 증착
- 높은 증착 Rate
- Plasma 안정성 확보
- 표면 Roughness 확보

→ **Low Damage 구현**

적용 가능 분야

- 차세대 OLED 전극 공정
- 투명전극층 형성 공정
- 페로브스카이트 태양전지 전극
- 고효율 에너지 소자 박막

GROWTH POINT 디스플레이 Sputter 기술 → OLED · 투명전극 · 태양전지 **차세대 전극 공정 시장으로 적용 영역 확대**

KEY COMPETENCY

02 이차전지 (1) 핵심 장비 및 경쟁력

전극 공정 장비와 물류 자동화 라인업으로 차세대 시장에 대응합니다



전극 Roll Press

Tandem Type

활물질이 도포된 전극 기재를
일정한 두께로 압연

- 고정/조절 IP Digital Alignment
- 전극 파단 예지 및 감지 시스템
- 무지부 Press 고도화
- Main Roll 온도 균일화



Slitter

슬리터

전극 폭을 규격에 맞게 절단

- 자동 칼날 위치 설정 가능
- Rewind Gap 및 터치모드 제어
- 고기능성 필름을 위한
  저장력 제어

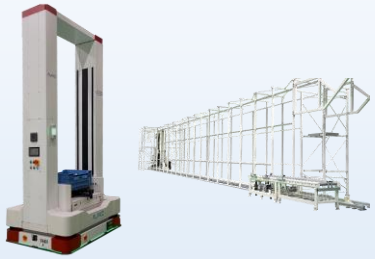


전극용 테이핑기

Taping

무지부 접힘을 막아 활물질
탈락 방지·안전성 유지

- Center 보정 Taper Roll 구성
- Tape End 감지 장치
- 이물질 방지용 STS 재질 Cover



자동화 시스템

AMR, Battery Stocker

고밀도 보관 및 자동화 기반
물류 운영을 통한 공간 활용도
및 처리 효율 향상

- 물류 환경과 고객사 니즈에
  최적화된 맞춤형 솔루션 제공

AI AUTOMATION

AI 기반 물류 자동화

AI가 물류 · 설비 데이터를 학습해 **이송 경로 · 작업 최적화**, **설비 이상 예측**, 보관 · 입출고 효율화를 구현

AMR **Battery Stocker** **Mobile Shuttle**

OUR STRENGTH

아바코 핵심 경쟁력

- **CAPA 확대** · 이차전지 장비 6천억원 규모 생산 가능
- **노하우 보유** · 디스플레이 물류·공정 장비 경험
- **글로벌 네트워크** · Top-tier 매출처 보유

NEXT 차세대 공정장비 개발 — **건식전극공정 장비**(원가 절감 · 생산성 향상) · **리튬메탈음극공정 장비**(에너지 밀도 10배 이상)

KEY COMPETENCY

02 이차전지 (2) 차세대 공정장비 개발

차세대 고효율 공정장비 개발로 경쟁력을 강화하고 매출을 다각화합니다

DRY ELECTRODE

건식전극공정 장비

	STEP 01	STEP 02	STEP 03	STEP 04	STEP 05
기존 습식	믹싱 공정	슬러리 제조	슬러리 코팅	용매 건조	롤 프레싱
건식	믹싱 공정	고체 파우더	파우더 코팅	건조 공정 생략	롤 프레싱

슬러리 제조 · 용매 건조 없이 고체 파우더를 직접 코팅

TECH
기술 난이도 高

COST
원가 절감

YIELD
생산성 향상

LITHIUM METAL ANODE

리튬메탈음극공정 장비

단계	리튬이온 배터리	리튬메탈 배터리
음극 준비	흑연 슬러리 코팅 및 건조	리튬 증착 및 압착
전해질 충전	액체 전해질 주입	고체 전해질 도포 또는 특수 전해질
셀 조립	층상* 조립 또는 권취**	박막 셀 조립 또는 고체 상태 조립
포메이션 충전	표준 충전	덴드라이트*** 억제를 위한 특수 충전 프로토콜

DENSITY
에너지 밀도 10배 이상 증가

CHARGE
배터리 충전 속도 우위

LIFE
방전율 감소 및 수명 연장

*층상 구조: 산소로 만들어진 팔면체 구성 층들이 규칙적으로 쌓여 있는 구조 **권취: 배터리의 여러 층을 말아 감아서 하나의 셀로 만드는 과정 ***덴드라이트: 리튬이온배터리 충전 시 음극 표면에 나뭇가지 형태로 쌓이는 리튬 결정체

KEY COMPETENCY

03 신성장동력 (1) PlasmaLine : 첨단 패키징 건식 공정 장비

PCB · 유리기판 공정장비로 글로벌 시장 진출을 확대하고 있습니다

PlasmaLine



세계 최초 개발 완료

에칭과 증착 연속 수행

FUNCTION · 기능

PCB 및 Glass 기판에 박막을 코팅하기 위해
에칭과 증착을 연속 수행하는 건식 공정장비

FEATURE · 특징

- 고성능 전자제품 산업에 적용 가능
- 고밀도 다층 기판 및 IC 기판 제품 개발에 용이
- 플라즈마를 활용한 에칭* · Desmear** · Seed Layer 형성
- **PCB 공정에서 Glass 기판 패키징 공정으로 확장**

2020
장비 개발
PCB 건식공정 및 플라즈마를 활용한 EDR 장비 개발 (글로벌 기업 협업)

TRACK RECORD
납품 완료
PCB 제조업체 납품 완료 (N社, D社)

중국 · 대만 · 유럽

UPGRADE
고도화 및 사업 확장
- 고객사 양산화를 위한 초기 성능 검증 완료, 양산 대응 중
- **미세 선폭 패턴 가공**으로 AI 반도체·고성능 전자제품 시장 공략

2026(E)
글로벌 진출 확장
국내외 업체와 양산 테스트 및 R&D용 장비 수주 목표

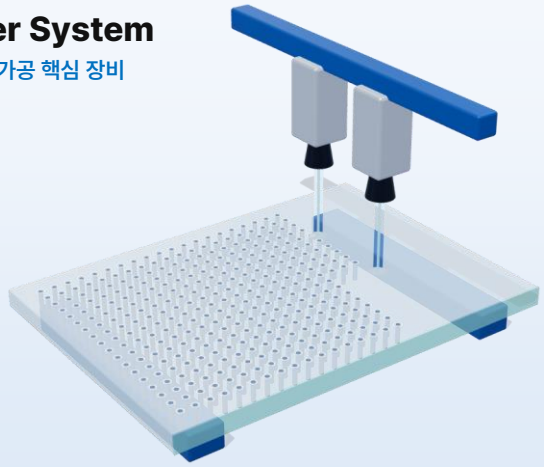
*에칭: 화학 약품의 부식 작용을 이용해 재료 표면을 선택적으로 원하는 모양이나 패턴을 만드는 가공법 (Etching)
**Desmear: PCB 제조 공정에서 드릴링 후 잔여 레진(Smear)을 제거하는 과정. 보통 화학물질로 제거하나 HDI, 반도체 기판 등은 플라즈마 방식 사용

03 신성장동력 (2) TGV Solution : 유리기판 공정 대응 확대

유리기판 미세홀 가공부터 증착·식각까지 공정장비 포트폴리오를 확대합니다

TGV Laser System

유리기판 미세홀 가공 핵심 장비



- 반도체 패키징용 유리 기판에 **미세한 홀을 정밀 가공**하는 레이저 시스템
- 베셀(Bessel)* 광학계로 균일하고 긴 초점 영역 형성

미세 크랙을 억제한 **레이저 유리 개질 기술**	고종횡비 홀 형성 **정밀 가공 기술**
Dual Optical Heads **2배 이상 패터닝 속도**	다양한 유리 소재 **대응 가능**

유리 · FC-BGA** · ABF Substrate*** 적용
플라즈마 에칭 기반 미세회로

0.5μm 이하

아바코 TGV설비 현황

1



Laser Modification
레이저를 이용하여 유리 기판에 **미세 홀 가공**

2 DEMO 설비보유



Glass Etching
화학적 에칭 공정을 통해 **홀 내부 및 표면 정밀 가공**

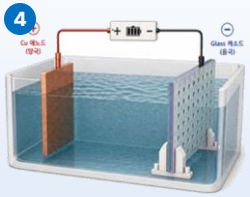
3



Seed Layer Coating
스퍼터링 공정으로 **금속 박막을 균일하게 증착**

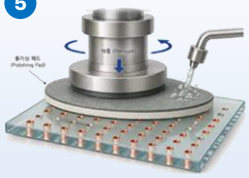
2027년 개발완료 계획

4



Cu Plating
전해 도금 공정으로 **홀 내부 금속 두께 형성**

5



Polishing (CMP)
CMP 공정을 통해 **평탄화 및 잔여 손상층 제거**

6



Inspection
광학 검사로 **홀 100% 검사** 및 hole의 진원도 검사

GROWTH POINT

AI 반도체 시대, Glass 기판으로 차세대 패키징 시장 진입 확대

칩이 커지고 열이 많아지는 AI 반도체에는 **열과 휘어짐에 강하고, 더 촘촘한 회로를 만들 수 있는 Glass 기판**이 차세대 소재로 부상

2027(E)

글로벌 진출 확장

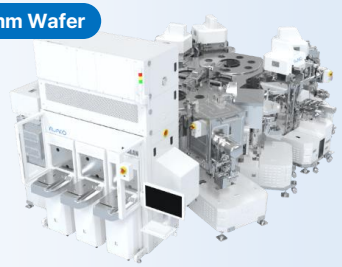
국내외 업체와 양산 테스트 및 R&D용 장비 수주 목표

*베셀: 좁은 영역에 빔을 집속하여 에너지 소모를 줄이고 집중도를 높여 미세 패턴 형성을 용이하게 하며, 레이저 천공/드릴링, 레이저 글래스 컷팅 등 다양한 레이저 가공 분야에 응용됨
**FC-BGA: 반도체 칩을 뒤집어 기판에 직접 붙이고, 아래쪽에 볼 모양 단자를 배열하는 고성능 패키징 기술 ***ABF Substrate: 고성능 반도체 패키징에 사용되는 빌드업 절연 소재로, 미세한 패키지 연결을 외부 회로와 연결하는 기반 역할을 함

03 신성장동력 (3) 반도체 : 핵심 장비 및 시장 진출 전략

HBM 등 첨단 패키징용 증착·검사 장비로 고부가가치 반도체 시장에 진출합니다

300mm Wafer



Metal Sputtering System

기능

- 반도체용 박막 특성을 제어해 **다목적 초순도 금속 박막** 제조
- HBM 등의 WLP(Wafer Level Package) 공정 및 Fab 공정에서 금속 박막 증착

특징

- 높은 신뢰성과 비용 측면의 이점 제공
- 고객 요구사항에 따른 장비 구성 가능
- EFEM* 기반 자동화 공정 적용으로 **높은 생산성** 구현

200mm Wafer



Metal Sputtering System

기능 반도체용 박막 특성을 제어해 다목적 초순도 금속 박막 제조

특징 기존 공정 방식인 VCE(Vacuum Cassette Elevator)로 처리해 **특수 공정 · 소량 생산에 적합**

Inspection



3D Inspection System

기능 Wafer 검사 및 리뷰 시스템으로 Wafer의 높이 · 위상 정보 측정

특징 3D 검사 방식의 정확한 측정 및 분석, **nm 수준 형상 검출** 가능

마케팅 타겟 기업

IDM & Foundry

SK hynix
SAMSUNG 삼성전자
DB HiTek
Magnachip

OSAT & Others

LB Semicon
Amkor Technology
nepes
ASE Korea
SFA 반도체
STATSChipPAC
HANA MICRON
삼성전기
onsemi
Signetics

단계별 추진 전략

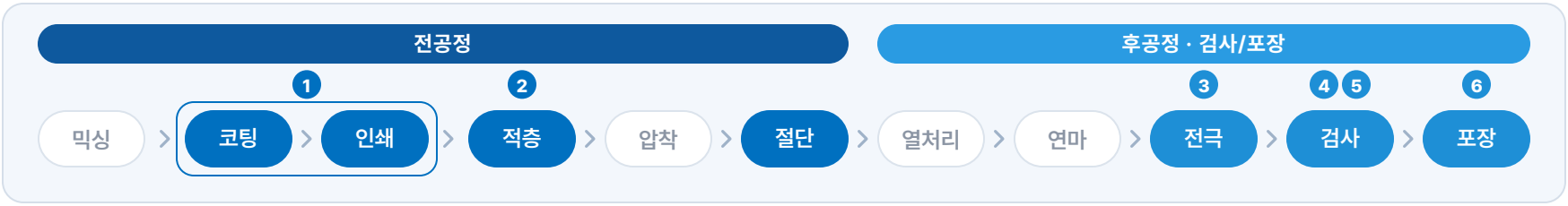
01	반도체 시장·기술 조사 (경쟁사, 제조사 등)	
02	반도체 제조사와 Sample · Wafer 데모	
03	양산라인 데모 평가 및 검증 (사양 및 신뢰성)	NOW
04	양산 검증 기반 상용화 구축	NEXT

우수한 장비 경쟁력 및 전략으로 고부가가치 반도체 산업 진출

*EFEM: 반도체 공정 장비의 전면부에 위치하여 웨이퍼를 안전하게 보관하고 공정 장비로 자동 공급하는 장치 (Equipment Front End Module)

03 신성장동력 (4) MLCC : 주요 공정 장비 개발 완료

코팅·적층부터 검사·포장까지, MLCC 제조 핵심 공정 장비를 개발 완료했습니다





1 Coating · Printing System 코팅기·인쇄기

내부 전극을 **고속 · 연속 인쇄**하고 열풍 건조하는 코팅기와 그라비어 유닛을 합성한 인쇄 시스템

MLCC 제조 핵심 장비



2 Stacking System 적층기

세라믹 시트를 박리하고 **높은 전기적 특성을 유지**하며, 정렬 위치를 보정해 적층



3 Dipping System 도포기

칩 측면에 **구리 외부 전극**을 적용



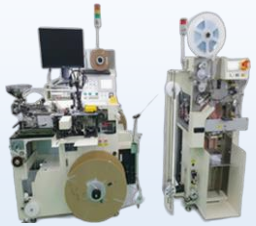
4 Arranging System

초음파 검사를 위해 **MLCC 적층 방향을 자동 정렬**



5 N.G Chip Removing System

초음파 검사 이미지를 활용해 **불량 칩을 자동 선별**



6 Taping System

완성된 칩을 정렬 공급·검사 후, **양품만 테이핑**하여 자동 공급된 Reel에 권취

03 신성장동력 (4) MLCC : 적층기 글로벌 공급 확대

하이엔드 적층기 기술로 해외 MLCC 제조사와 관계사 공급을 확대합니다

AVACO STACKING SYSTEM

하이엔드 MLCC 적층기 국내외 공급 확대

하이엔드 제품을 포함한 전 모델 대응[1)]



GLOBAL · 해외 영업

중국 MLCC 제조사에 **하이엔드 MLCC 적층기** 등 공급 예정

다수 중국 MLCC 제조사와 공급 협의 진행[1)]

DOMESTIC · 관계사

관계사 MLCC 생산라인 증설에 **적층기 등 핵심 장비 공급** 예정

적층기 핵심 기술

01	**高 전기적 특성 유지 Align 기술**	PC Vision 적용 · 분해능 향상
02	**2-Head 방식 생산성 향상**	리니어 모터 적용
03	**고강성 · 고정도 프레스 Unit**	제로 백래시
04	**Ceramic Sheet 정밀 박리 기술**	
05	**상 · 하 금형 제작 기술**	

관계사 증설에 따른 장비 수요

아바텍 · 박막 코팅 및 MLCC 생산

증설 계획	총 CAPEX	아바코 장비 공급
MLCC 생산라인 3개	**900억원**	적층기 등 공급 예정
태양광 및 전장용 라인 구성 예정	2027년 6월 말까지 집행 공시	**총 소요 CAPEX의 60% 이상 수주 예상**

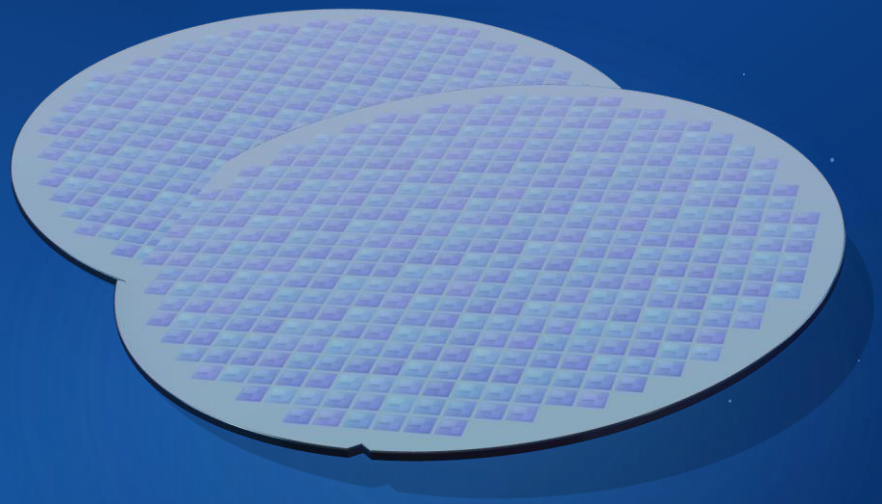
핵심 기술 기반 장비 고도화 → 신산업 진출 시 적용 가능한 포트폴리오 구축

1) 유안타증권 아바코 기업분석 리포트(2026.03) 참고

03

Chapter 03

Financial Highlights



실적 현황

요약 재무제표

주주친화 배당 정책

01 실적 현황

창사 이래 2025년 최대 매출 달성, 2026년 하반기 매출 인식 본격화를 준비합니다

2025년 매출액 · 창사 이래 최대
3,929 억원

2025년 영업이익 · 영업이익률
346 억원 8.8%

2026년 3분기 수주잔고
5,453 억원

연결 기준 (단위: 백만원)

구분	2023	2024	2025	2025.3Q	YoY	2026.3Q
매출액	**186,852**	**305,515**	**392,896**	**236,026**	-64.7%	**83,319**
디스플레이 제조장비	68,247	41,122	319,249	193,809	-89.5%	20,428
이차전지 제조장비	69,779	229,693	41,150	26,046	+82.8%	47,624
MLCC 제조장비	558	523	-	-	-	-
기타	48,268	34,177	32,497	16,171	-5.6%	15,267
매출원가	156,435	249,700	327,564	184,531	-57.1%	79,083
매출총이익	30,417	55,815	65,333	51,494	-91.8%	4,236
판매비와관리비	26,009	35,417	30,715	28,504	-16.9%	23,694
영업이익	**4,408**	**20,398**	**34,618**	**22,990**	-	**(19,458)**
영업이익률	2.4%	6.7%	8.8%	9.7%	-	-23.4%
당기순이익	**4,257**	**23,890**	**28,650**	**14,798**	-	**(27,205)**

출처: 사업보고서

COMMENT

매출액
- 중국 고객사향 디스플레이 장비 매출 반영 예정
- 이차전지는 북미 프로젝트 종료 후 **ESS · LFP 중심 신규 수요**에 대응

영업이익
- 3분기 매출 규모 축소에 따른 일시적 영업손실
- 수주잔고 **5,453억원** 기반 매출 인식 본격화 예정

당기순이익
- 3분기 영업손실 영향으로 당기순손실 기록
- 수주잔고 기반 **매출 인식 확대로 수익성 회복** 추진

02 요약 재무제표(연결)

2026년 3분기 자산총계 4,362억원, 안정적인 재무 구조를 유지하고 있습니다

재무상태표

(단위: 억원)

구분	2023	2024	2025	2026 3Q
유동자산	2,522	2,784	1,572	2,632
비유동자산	927	1,027	1,663	1,730
자산총계	**3,449**	**3,811**	**3,235**	**4,362**
유동부채	1,553	1,764	956	2,497
비유동부채	54	60	61	78
부채총계	**1,608**	**1,824**	**1,017**	**2,575**
자본금	80	80	80	80
자본잉여금	573	572	446	325
기타자본 구성요소	(14)	(40)	(5)	(96)
이익잉여금	1,203	1,376	1,698	1,469
자본총계	**1,842**	**1,987**	**2,218**	**1,788**

포괄손익계산서

(단위: 억원)

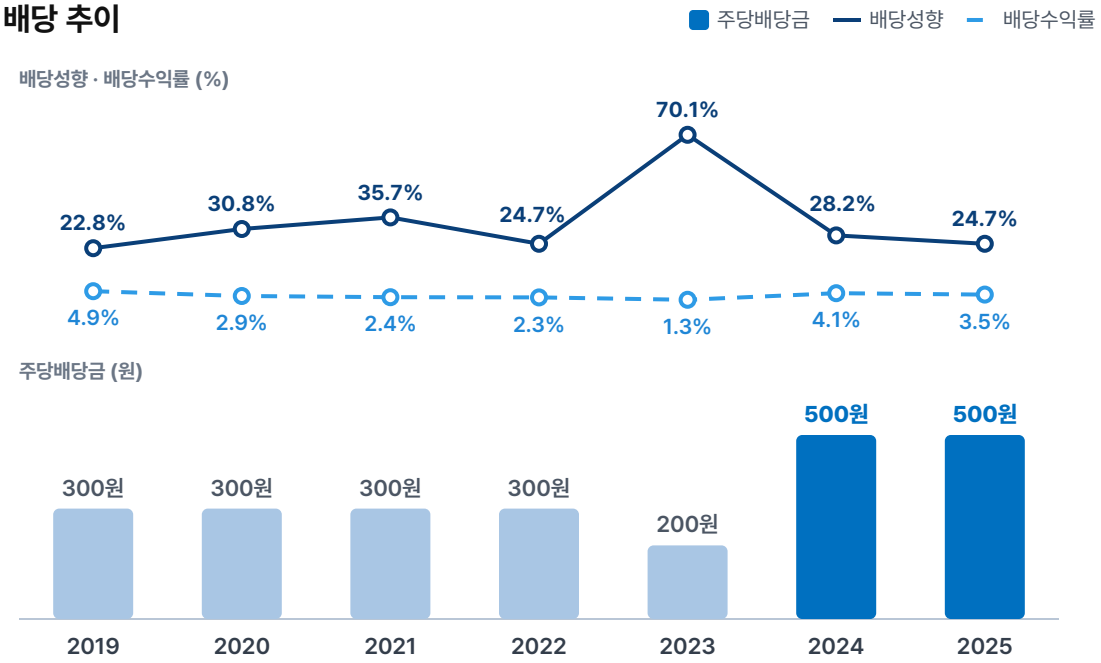
구분	2023	2024	2025	2026 3Q
매출액	**1,869**	**3,055**	**3,929**	**833**
매출원가	1,564	2,497	3,276	791
매출총이익	**304**	**558**	**653**	**42**
판매비와관리비	260	354	307	237
영업이익	**44**	**204**	**346**	**(195)**
금융수익	26	29	28	52
금융비용	32	49	28	4
기타수익	51	192	82	43
기타비용	33	79	97	158
세전계속사업이익	55	298	347	(262)
법인세	13	59	60	10
당기순이익	**43**	**239**	**287**	**(272)**

출처: 사업보고서 · 연결 기준

03 주주친화 배당 정책

고배당 기조와 감액 배당 재원 마련으로 주주 가치를 높입니다

배당 추이



2024~2025년 주당배당금

500 원

2025년 배당수익률 3.5%

감액배당 재원 마련

120 억원

자본잉여금 → 이익잉여금 전입
(2026년 3월 주주총회 통과)

DIVIDEND POLICY

- 고배당 정책 지속 → **주주친화적 배당 정책 실현**
- 2025년 창사 이래 최대 매출, **안정적 고배당 기조 유지**

CAPITAL REDUCTION DIVIDEND · 감액배당

- 개인주주 배당소득 비과세, 법인주주 과세 이연 효과
- 2026년 결산 배당부터 적용 가능

04

Chapter 04

Company Overview

회사 현황

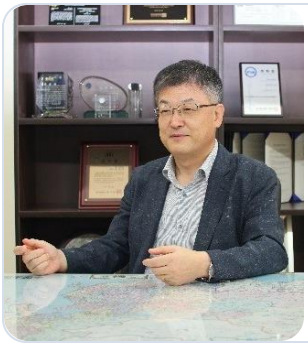
성장 연혁

01 회사 현황 및 성장 연혁

2000년 설립 이후 글로벌 장비 기업으로 도약하고 있습니다

회사 개요

법인명	주식회사 아바코
대표이사	김광현
설립일	2000년 01월 16일
임직원 수	467명
자본금	80억원
본점	대구광역시 달서구 성서4차첨단로 160-7
주요 제품	LCD·OLED 진공·전용 장비, 이차전지 자동화 시스템, 산업용 소재 제조용 Roll-to-Roll 장비, MLCC 장비



김광현 대표이사

'15 ~ 現	㈜아바코 대표이사
'10 ~ '15	㈜아바코 부사장
'86 ~ '10	LG전자 디스플레이 사업부
'84	영남대 기계공학과 졸업

주요 연혁

- **2000** ㈜AVACO 설립
- **2005** KOSDAQ 상장
- **2006** 국내 최초 LCD TFT Sputter(G7) 개발
- **2008** 국내 최초 박막태양전지용 In-line Sputter(G5) 개발
- **2010** 국내 최초 LCD CF/Sputter(G8) 개발
  AVACO Inc. (USA) 미국법인 설립
- **2013** AVACO Machinery (Guangzhou) 중국법인 설립
- **2018** 10.5세대 OLED용 Sputter 및 물류 장비 개발
  PCB & PLP Substrate용 Etcher & Sputter 개발
  MLCC 생산 장비 개발
- **2019** 반도체 FOWLP Metal Sputter 해외 기업과 전략적 제휴
- **2020** 이차전지 및 Roll-to-roll 장비 사업부 신설
  PlasmaLine – PCB 건식공정 장비 개발
- **2023** 상주 신공장 건립(상주일반산업단지)
- **2026** 미국 Yesol Inc. 인수
  TGV 레이저 가공장비 고도화